

KOSDAQ | 반도체와반도체장비

프로텍 (053610)

선단 패키징 수요와 함께 성장

체크포인트

- HBM 및 2.5D 패키징 시장 확대에 따른 동사 장비 수요 증가가 기대. 고객사들의 강한 투자로 인해 동사의 고사양 디스펜서 중심의 후공정 장비 공급 물량 확대가 전망
- Attach, Laser Bonder, Micro Solder ball Attach 등 장비 다변화 전망. 신규 장비들을 중심으로 기존 디스펜서 중심에서 고부가가치 본딩 장비사로의 체질 개선이 가속화될 것으로 판단
- 2026년 매출액 2,571억 원(+11.7% YoY), 영업이익 576억 원(+24.6% YoY)을 전망. Advanced Package향 고사양 장비 수요 강제 지속 기대. 고사양 디스펜서 공급 확대, 고마진 레이저 장비군 판매 증가로 OPM 22.4%를 전망

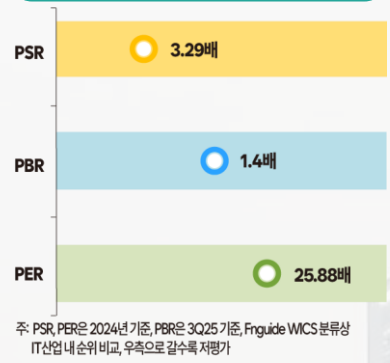
주가 및 주요이벤트



재무지표



밸류에이션 지표



반도체 후공정 장비 업체

반도체 후공정 장비 제조 업체. 주요 장비로 Dispenser, Attach, Laser Bonder, Micro Solder ball Attach, Automated Guided Vehicle 등을 생산. 주요 고객사로 삼성전자, SK하이닉스 등 IDM과 Amkor(미국), ASE(대만) 등 OSAT 업체들이 있음

Advanced Package 시장 확대와 함께 성장

HBM 및 2.5D 패키징 시장 확대에 따른 동사 장비 수요 증가가 기대. ASE, Amkor 등은 선단 패키징 공정 수요에 적극 대응하며 투자를 확대 중. 고객사들의 강한 투자로 인해 동사의 고사양 디스펜서를 중심으로 한 후공정 장비 공급 물량 확대가 기대. 또한 디스펜서 외 장비로 다변화 예상. Attach 장비는 삼성전자 HBM 공급을 바탕으로 향후 시장 확대가 기대되고 레이저 본더는 OSAT를 중심으로 공급 확대될 전망. 신규 장비들을 중심으로 기존 디스펜서 중심에서 고부가가치 본딩 장비사로의 체질 개선이 가속화될 것으로 판단

장비 다변화되는 2026년

2026년 매출액 2,571억원(+11.7% YoY), 영업이익 576억원(+24.6% YoY)을 전망. Advanced Package향 고사양 장비 수요 강세 지속 예상. Attach 장비는 OSAT향 수요가 지속되는 가운데 고객사의 HBM 투자 속도와 물량에 따라 실적 업사이드가 발생할 것으로 기대. 레이저 장비군은 전년 대비 약 20%의 성장 전망. 수익성 측면에서는 매출액 확대 및 고사양 디스펜서 공급 확대, 고마진 레이저 장비군 판매 증가로 OPM 22.4%를 전망

Forecast earnings & Valuation

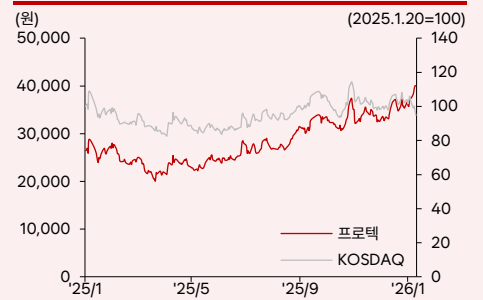
	2022	2023	2024	2025F	2026F
매출액(억원)	1,988	1,561	1,703	2,302	2,571
YoY(%)	14.2	-21.5	9.1	35.2	11.7
영업이익(억원)	601	174	134	463	576
OP 마진(%)	30.2	11.2	7.9	20.1	22.4
지배주주순이익(억원)	422	206	217	451	514
EPS(원)	3,834	1,874	1,971	4,096	4,668
YoY(%)	-10.6	-51.1	5.2	107.8	14.0
PER(배)	5.5	24.4	11.1	9.8	10.9
PSR(배)	1.2	3.2	1.4	1.9	2.2
EV/EBITDA(배)	2.7	16.7	6.4	5.2	6.5
PBR(배)	0.9	1.8	0.8	1.3	1.4
ROE(%)	16.2	7.4	7.4	13.9	13.9
배당수익률(%)	2.4	0.9	1.8	1.0	0.8

자료: 한국IR협회의 기업리서치센터

Company Data

현재주가 (1/29)	40,000원
52주 최고가	40,000원
52주 최저가	20,050원
KOSDAQ (1/29)	1,164.41p
자본금	55억원
시가총액	4,400억원
액면가	500원
발행주식수	11백만주
일평균 거래량 (60일)	5만주
일평균 거래액 (60일)	18억원
외국인지분율	4.28%
주요주주	최승환 외 1인 30.50%
	알파텍 14.85%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	208	436	389
상대주가	-32	-0.8	-131

참고

1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 'EPS 증가율', 수익성 지표는 'ROA', 활동성지표는 '총자산회전율', 유동성지표는 '당좌비율' 임. 2) 표지 밸류에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 밸류에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 밸류에이션 매력도 높음.



기업 개요

1 프로텍은 반도체 후공정 패키징 장비 전문 기업

프로텍은 2001년 코스닥 상장한 디스펜서, 본딩/레이저 장비 등 후공정 패키징 장비 전문 기업

프로텍은 1993년 디스펜서 설비 국산화를 통해 시장에 진입하고 1997년 법인 전환을 거쳐 2001년 코스닥 시장에 상장한 반도체 후공정 패키징 장비 업체이다. 정밀 디스펜서는 반도체 패키징 공정에서 접착제, 보강제, 절연물질 등을 정밀하게 도포하는 자동화 설비로, 칩과 기판을 접합하는 과정에서 정해진 양의 물질을 고정 위치에 반복적으로 도포해야 하기 때문에 정밀도와 반복성이 핵심이다. 주요 고객사로는 글로벌 OSAT 업체인 대만 ASE, 미국 Amkor, 중국 JCET와 삼성전자, SK하이닉스 등이 있다. 글로벌 경쟁사로는 미국 Nordson, 일본 Musashi Engineering, 독일 Vermes, 스웨덴 Mycronic 등이 있으며, 이들은 40~50년간 하이엔드 디스펜서 장비 시장을 주도해왔다.

스마트폰 투자가 활발했던 2010년~2019년에는 스마트폰 기판에 각종 칩과 부품을 실장하고 방수·방진 처리를 위한 코팅 공정에서 디스펜서 수요가 급증하며 매출이 증가했다. 이후 2020년대 들어서는 반도체 후공정 투자가 재개되었다. 2023년 반도체 공급 과잉으로 설비 투자가 감소하면서 매출이 일시적으로 감소했으나, 2024년 이후 AI 가속기 등 고성능 반도체 투자가 본격화되며 실적 회복세를 보이고 있다. 한편, 동사는 디스펜서만으로는 매출 성장에 한계가 있다고 판단하여 신기술 개발과 신규 장비군 확장을 지속해왔다. 이는 크게 본딩 장비와 레이저 장비라는 두 개의 축으로 구성되며, 최근 2년간 가시적인 성과가 확인되고 있다.

반도체 후공정 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 본딩 공정이다. 본딩 장비 시장은 네덜란드 Besi, 일본 신카와 등 선진 업체가 오랫동안 주도해온 영역으로 국산화가 어려웠다. 초기에는 선진 업체 대비 50~60% 수준의 성능이었으나, 약 10여년간 장비 개발을 지속한 결과 2025년 선진 장비와 비교가능한 기술 수준에 도달한 것으로 보인다. 또한, 레이저 장비는 2015년부터 2017년 사이 미국 Amkor와 공동 개발해 시장에 진입했다. 초기에는 리플로우 공정용 레이저 장비로 연간 50~100억 규모의 매출이 발생했다. 이후, 2.5D 패키징과 HBM 구조가 확산됨에 따라 열압착 공정인 TC 본더의 필요성이 급증해 동사 레이저 본더가 본격 시장에 진입했다. 현재는 본딩과 레이저가 결합된 제품 등 신규 장비들을 중심으로 기존 디스펜서 중심에서 고부가가치 본딩 장비사로의 체질 개선을 가속화하고 있다.

프로텍 연혁

1993~2001	2002~2009	2010~
<p>1993 (주)프로텍 설립</p> <p>1997 (주)프로텍 법인전환</p> <p>1999 METAL WORK (Italy) 유럽 수출 공급계약 체결 첨단제품우수 벤처기업 지정 ISO 9001 인증 획득</p> <p>2000 유망 중소기업 선정 경기도지사 중소기업수출기업화사업 대상기업 선정 해외무역진흥 대통령 표창 안전공장준공 및 사업장 이전</p> <p>2001 기업부설연구소 설립 반도체산업협회 회원기업 코스닥 상장 중소기업청장 유망선도기업 지정 해외무역진흥 대통령 표창</p>	<p>2002 무역의 날 5백만불 수출탑 및 대통령 표창 코리아 테크놀로지 패스트50 선정</p> <p>2003 부품소재 수출리딩컴퍼니 인증 중소기업청 이노비즈 기업 선정 기술신용보증기금 우량기술기업 선정</p> <p>2004 고산, 남동공단, 의왕지점 설립 산업자원부 부품소재전문기업 인증</p> <p>2008 무역의 날 천만불 수출탑 수상</p> <p>2009 프로텍 제2공장 이전 싱가포르 R&D센터 설립</p>	<p>2010 무역의 날 이천만불 수출탑 및 은탑산업훈장 수훈</p> <p>2011 포브스 선정 아시아 200대 중견기업 선정 일본 미나미 인수</p> <p>2014 삼성전자 협성회 가입 무역의 날 오천만불 수출탑 수상</p> <p>2015 삼성전자 동반성장 협력상 수상 안양 평촌 신사옥 준공이전</p> <p>2019 무역의 날 일억불 수출탑 수상</p> <p>2020 뉴메틱 사업부 분리</p> <p>2022 Laser Reflow 출시</p> <p>2023 종속회사 (주)스트라토아이티는 (주)프로텍에 흡수합병 완료</p> <p>2024 종속회사 미나미 증자(4억4천만엔)</p> <p>2025 연결대상 종속기업 상호변경 (주)비릿지필인베스트먼트 → (주)프로텍벤처스</p>

자료: 프로텍, 한국IR협회의 기업리서치센터

2 종속회사 현황

3Q25말 기준 프로텍의 연결대상 종속회사는 6개사

프로텍은 3Q25말 기준 6개의 연결대상 종속회사를 보유하고 있다. 일본 현지 법인 **MINAMI CO.,LTD(지분율 100.0%)**는 볼 플레이어, 스크린프린터 등을 제조하며 3Q25말 누적 기준 매출액 95억 원, 당기순이익 16억 원을 기록했다. **(주)피엔엠(지분율 100.0%)**은 프로텍의 국내 부품 계열사로 3Q25말 누적 기준 매출액 342억 원, 당기순이익 72억 원을 기록했다. **(주)프로텍엘엔에이치(지분율 96.88%)**는 산업용전자기기 개발 및 제조 기업으로 3Q25말 기준 당기순손실 2.3억 원을 기록했다. **(주)프로텍인베스트먼트(지분율 100.0%)**는 투자 전문 회사로 **(주)프로텍벤처스** 지분율을 100% 보유하고 있다. **(주)피엔티(지분율 42.73%)**는 프로브 카드 관련 부품을 전문으로 생산하는 코스닥 상장사로, 2025년 매출액, 영업이익은 각 247억 원(+1.48% YoY), 205억 원(적자 확대 YoY)을 기록했다.

프로텍 지분도



주: 3Q25말 기준, 자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터

동사는 반도체 후공정 장비인
Dispenser를 주력으로
Laser Bonder, Micro Solder
ball Attach, Automated
Guided Vehicle 등을 생산

주요 사업 및 매출 구성

동사의 주요 장비는 반도체 후공정 장비인 Dispenser, Attach, Laser Bonder, Micro Solder ball Attach, Automated Guided Vehicle 등을 생산한다. 주요 고객사로 삼성전자, SK하이닉스 등 IDM과 Amkor, ASE 등 OSAT 업체들이 있다.

Dispenser

동사 매출액의 약 50%를 차지하는 주력 장비로 반도체 칩을 기판에 부착하거나 보호하기 위한 액체 소재를 정밀하게 분사하는 장비이다. 회로 기판과 반도체 칩 사이의 빈공간에 절연 수지를 채워 넣어 충격으로부터 칩을 보호하는 언더필(Underfill) 공정, 칩을 리드프레임이나 기판에 접착하는 다이 어태치(Die Attach) 공정, 특정 영역에 벽(Dam)을 쌓고 그 내부를 채워(Fill) 회로를 보호하는 댐 앤 필(Dam & Fill) 공정 등에 사용된다.

Attach

웨이퍼에서 잘라낸 개별 칩(Die)을 집어 올려 접착제가 도포된 기판이나 리드프레임 위에 정확히 내려놓는 장비이다.

Laser Bonder

다이와 기판을 붙일 때 사용되는 Laser Reflow 장비(Laser Assisted Bonder)와 가압 기능이 포함된 Laser Compression Bonder가 있다.

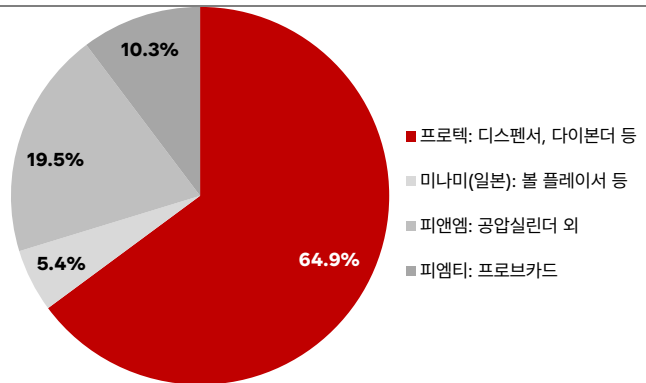
Micro Solder ball Attach

반도체 칩과 기판을 연결하는 아주 작은 전극인 솔더볼을 정밀하게 부착하는 장비이다. 반도체 패키징 기술이 발전하면서 칩의 입출력 단자(I/O) 개수는 많아지고 크기는 작아졌다. 따라서 직경 수십 마이크로미터 수준의 아주 미세한 솔더볼을 사용해야 한다. 동사 장비는 마이크로 솔더볼 뿐만 아니라 카퍼 필러(Copper Pillar Bump)에도 사용 가능하다.

Automated Guided Vehicle

공정 간 물류를 자동으로 연결하는 자동화 장비이다. 원재료(기판, 웨이퍼 등)를 보관 창고에서 디스펜서나 어태치 장비 입구로 자동 운반하고 모든 공정이 끝난 후 검사 장비나 출고 구역으로 이송한다.

프로텍 매출 비중



주: 3Q25말 기준, 자료: Dart, 한국R협회의 기업리서치센터

프로텍 사업군



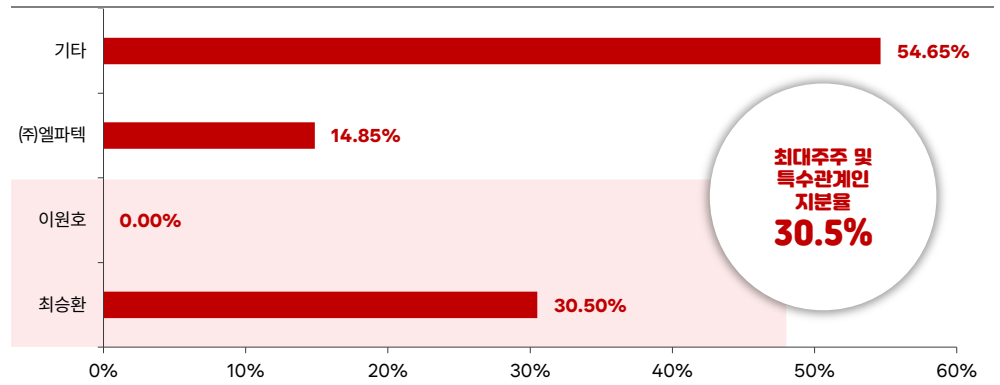
자료: 프로텍, 한국R협회의 기업리서치센터

주주 구성

3Q25말 기준 프로텍의
최대주주는 대표이사 최승환으로
지분 30.50% 보유

3Q25말 기준 프로텍의 최대주주는 대표이사 최승환으로 지분 30.50%를 보유하고 있다. 최승환 대표이사는 대흥기업과 기성산업(주)의 대표이사를 역임했으며, 현재는 (주)프로텍엘앤에이치의 대표이사(2016년 3월 취임)와 (주)피앤엠 이사를 겸직하고 있다. 5% 이상 주주인 (주)엘파텍은 3Q25말 기준 동사 지분 14.85%를 차지하고 있다.

프로텍 주주 현황



주: 3Q25말 기준, 자료: Dart, 한국IR협회의 기업리서치센터



산업 현황

1 반도체 시장 전망

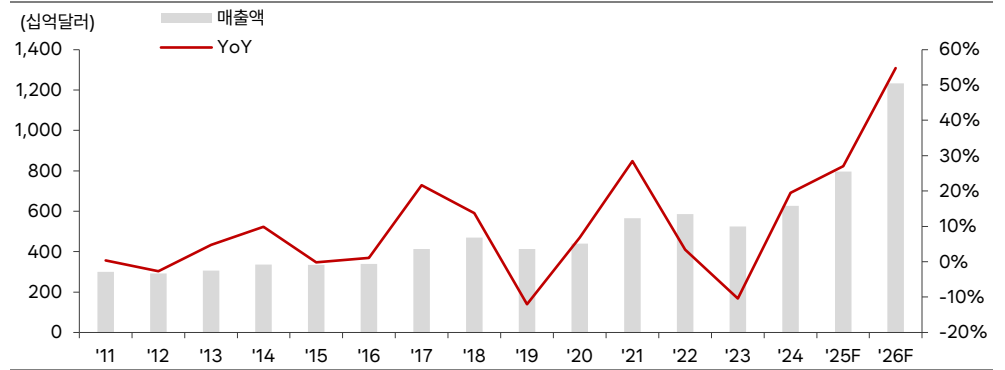
2026년 글로벌 반도체 시장은 강한 AI 수요에 따라 로직, 메모리 중심 성장에 따라 전년 대비 54.8% 성장한 1.23조 달러 전망

2025년 글로벌 반도체 시장은 전년 대비 27.1% 성장한 7,961억 달러를 기록할 것으로 전망되어 당초 전망치를 상회할 것으로 예상된다. AI 관련 어플리케이션, 컴퓨팅 및 데이터센터 인프라의 강한 수요로 인해 로직과 메모리 부문이 예상치를 상회하며 성장하고 있기 때문이다. 2025년 로직 반도체는 +37.1% YoY, 메모리는 +45.8% YoY 성장할 것으로 보인다. 그 외 제품군은 2024년 부진 이후 회복세를 보이고 있으나 회복 속도는 여전히 더디다. 센서 +10.4% YoY, 마이크로프로세서 +7.9% YoY, 아날로그 +7.5% YoY, 광소자 +3.7% YoY 가 예상되고 개별소자는 차량 어플리케이션 부진 지속으로 -0.4% YoY 감소할 것으로 보인다.

2026년 글로벌 반도체 시장은 전년 대비 54.8% 성장한 1.23조 달러를 기록할 것으로 예상된다. 2026년에도 로직과 메모리 중심의 성장이 예상되며 모든 지역과 제품군에서 성장 또한 전망된다. 로직은 +32.1% YoY, 메모리 +134.3% YoY로 2024년과 2025년에 이어 큰 성장을 이룰 것으로 보인다. 다른 제품군은 +5.7~13.9% YoY의 점진적인 회복세를 이어갈 것으로 예상된다. 2026년은 과거 시장에 영향이 컸던 소비자 및 산업 수요보다는 AI 수요에 매우 집중되고 주도될 것이다. AI 서버를 포함한 글로벌 서버 출하량이 2026년 전년 대비 12.8% 성장할 것으로 전망되어 로직 및 메모리 수요를 견인할 것이다. 2024년에서 2025년 상반기까지의 서버 시장은 GPU와 HBM을 탑재한 AI 서버 중심의 병렬 컴퓨팅, 즉 대규모 언어 모델(LLM) 학습이 주도해 왔다. 그러나 2025년 하반기를 기점으로 AI 에이전트, LLaMA 기반 앱, Copilot 업그레이드 등 실질적인 서비스가 확산됨에 따라 CSP들의 수익 창출 전략이 AI 추론 서비스로 급격히 전환되고 있다. 현재 AI 추론 워크로드는 전용 AI 서버 랙에 국한되지 않고, 추론 전후의 데이터 처리 및 스토리지를 담당하는 범용 서버까지 영역이 확장되고 있다. 북미 5대 CSP(Google, AWS, Meta, Microsoft, Oracle)의 2026년 CAPEX는 전년 대비 40% 증가할 전망이다. 이는 신규 인프라 구축뿐만 아니라 2019~2021년 클라우드 붐 당시 도입된 노후 범용 서버의 교체에도 사용될 전망이다. 특히 Google(Gemini)과 Microsoft(Copilot)는 서비스 운영 과정에서 발생하는 막대한 일일 추론 트래픽을 감당하기 위해 범용 서버 확충에 가장 공격적이다.

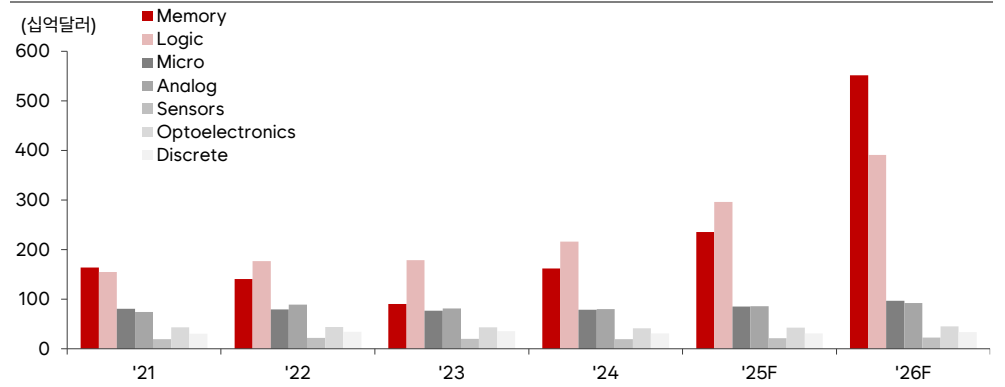
AI 서버를 포함한 글로벌 서버 출하량이 2026년 전년 대비 12.8% 성장할 것으로 전망되어 로직 및 메모리 수요를 견인할 것이다. 특히 메모리는 AI 추론 워크로드가 증가함에 따라 기존 DRAM과 HBM에 대한 수요가 급증하면서 단기간으로 이례적인 가격 상승세를 보이고 있다. AI 시스템은 대규모 모델 매개변수 처리, 장시간 추론, 다중 작업 병렬 처리를 위해 고대역폭, 대용량, 저지연 DRAM에 더욱 의존하게 되고 NAND는 빠른 데이터 전송에 필수적인 요소가 된 반면 메모리 생산 능력은 제한된 상황이 지속되기 때문이다. 역사적 분기별 메모리 가격 상승률은 최고 35% 정도였으나 최근에는 50% 이상 급등세를 보이고 있다. 로직과 메모리의 성장 기여를 제외한다면 2026년 반도체 성장률은 +9.4% YoY에 그칠 것으로 보인다.

글로벌 반도체 시장 규모 추이



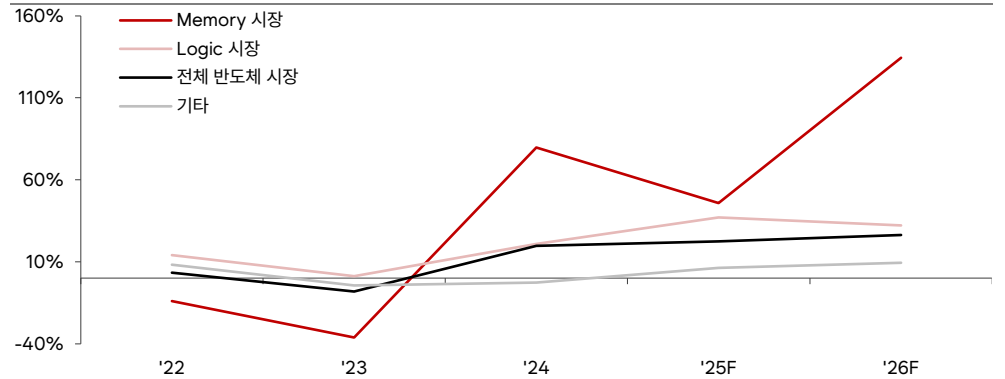
자료: WSTS, Trendforce, 한국R협의회 기업리서치센터

글로벌 반도체 부문별 시장 규모 추이



자료: WSTS, Trendforce, 한국R협의회 기업리서치센터

글로벌 반도체 부문별 시장 규모 추이 YoY



자료: WSTS, Trendforce, 한국R협의회 기업리서치센터

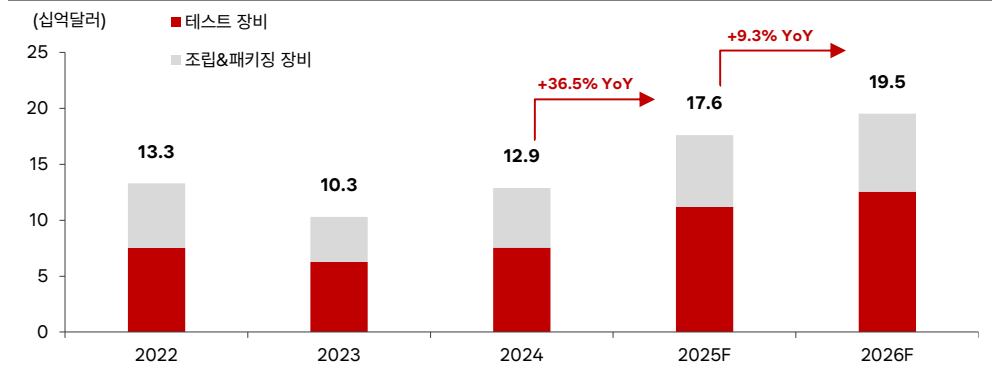
반도체 장비 시장 전망

AI 및 HBM 반도체 스펙 향상에 따른 후공정 장비 시장 성장 지속 기대

AI 관련 투자에 따라 최첨단 로직, 메모리 및 선단 패키징 기술 도입에 힘입어 반도체 제조업체의 반도체 설비 투자는 증가세를 보이고 있다. 2025년 글로벌 반도체 장비 매출은 전년 대비 13.8% 성장한 1,333억 달러로 사상 최대치를 기록할 것으로 예상된다. 이와 같은 성장세는 향후 2년간 지속될 것으로 보여 2026년에는 1,456억 달러(+9.3% YoY), 2027년 1,561억 달러(+7.2% YoY)에 달할 것으로 전망된다.

후공정 장비는 2024년부터 시작된 강한 회복세가 지속될 것으로 예상된다. 2025년 후공정 장비 시장은 전년 대비 36.5% 증가한 176억 달러로 전망된다(SEMI). 테스트 장비는 2024년 전년 대비 20.3% 성장하며 강한 회복세를 보인데 이어 2025년에도 48.5% 급증하며 112억 달러에 이를 것으로 전망된다. 조립 및 패키징 장비는 2024년 전년 대비 32.8%의 큰 폭의 성장세를 기록하였으며 2025년에는 전년 대비 19.6% 성장한 64억 달러를 기록할 것으로 예상된다. 후공정 장비 부문 성장은 지속되어 테스트 장비는 2026년 +12.0% YoY, 2027년 +7.1% YoY 증가가 전망된다. 조립 및 패키징 장비는 2026년 +9.2% YoY, 2027년 +6.9% YoY 성장할 것으로 예상된다. 자동차, 산업 및 소비자 시장의 지속적인 약세에도 불구하고 디바이스 아키텍처의 복잡성이 증가와 AI 및 HBM 반도체의 스펙 향상이 후공정 장비 시장 성장을 견인하고 있다.

글로벌 반도체 후공정 장비 시장 규모 추이



자료: SEMI, 한국IR협의회 기업리서치센터

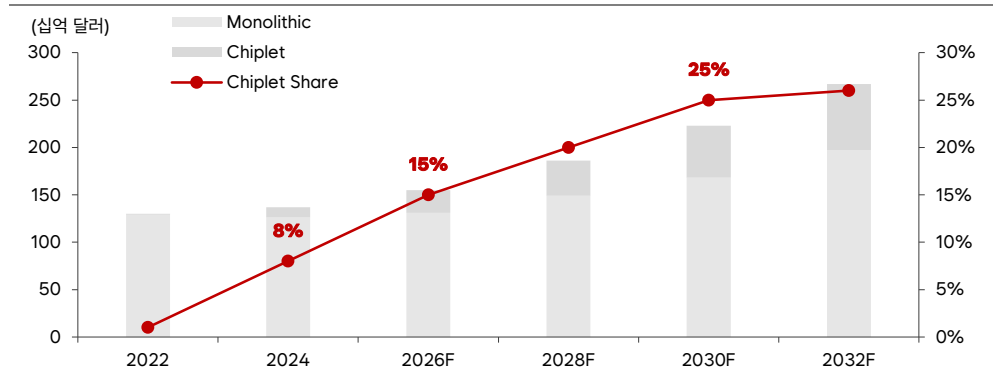
후공정 장비는 HBM, 2.5D 패키징 중심 성장 전망

후공정 장비는 AI 반도체향 첨단 패키징 중심으로 성장

후공정 장비 투자는 AI 반도체향 첨단 패키징(Advanced Packaging)을 중심으로 성장 중이다. AI 가속기 시장의 확대 로 인해 HBM 및 고성능 컴퓨팅(HPC)향 패키징 수요가 전체 시장 성장을 견인한다. 2.5D, 3D 패키징 기술을 사용한 Chiplet이 전체 반도체에서 차지하는 비중은 2024년 8%에서 2026년 15%, 2030년 25%까지 확대될 것으로 전망 된다. 기존 모놀리식 다이(Monolithic Die, 싱글 칩 디자인)의 기술적 한계와 비용 문제를 해결하기 위해 칩렛 구조 채택이 이어지고 있다. Foundry는 TSMC를 중심으로 삼성전자, Intel은 CoWoS, SoIC 등 2.5D, 3D 첨단 패키징 후공정 라인에 투자를 집중하고, 메모리 업체는 HBM 양산을 위한 TSV 공정에 투자를 확대하고 있다. OSAT는 상위 업체들 중심으로 Foundry가 소화하지 못한 첨단 패키징 물량을 받기 위해 투자 중이다.

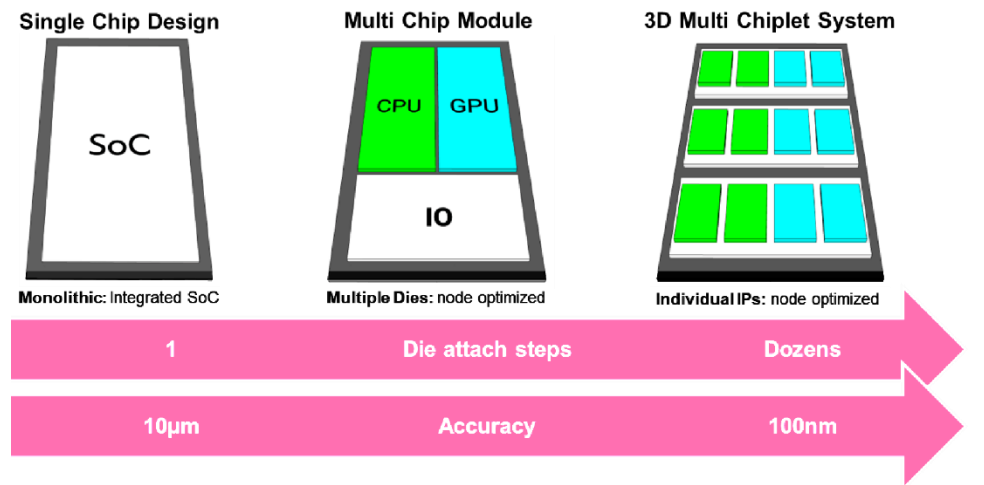
CoWoS 수요의 급속한 확장으로 글로벌 파운드리 환경이 바뀌고 있다. 선두 업체인 TSMC는 CSP의 AI 관련 주문 폭증으로 생산 능력 한계에 직면하고 있다. ASE와 같은 OSAT들이 CoWoS 물량의 일부를 흡수했지만, 수율 및 규모 확장에 어려움을 겪고 있다. TSMC의 CoWoS 생산 능력은 Nvidia의 GB200 및 GB300 플랫폼 생산량 확대와 Google의 TPU, AWS의 Tranium, Meta의 MTIA 가속기용 ASIC 생산에 힘입어 2026년 말까지 웨이퍼 기준 월 10 만장을 넘어설 것으로 예상된다. AI 가속기, 네트워킹 ASIC, 차세대 스마트폰 SoC는 성능, 대역폭 및 에너지 효율 향 상을 위해 2.5D 및 3D 패키징 기술이 지속적으로 확대되고 있고 첨단 패키징 애플리케이션의 전반적인 성장세가 이 어질 것으로 전망된다. AI 수요의 지속적인 강세는 선단 노드와 첨단 패키징 기술의 성장이 긴밀하게 연관되어 데이터 센터, 소비자 가전, 그리고 차세대 지능형 시스템 전반에 걸쳐 차세대 반도체 혁신을 위한 필수적인 기술로 자리잡고 있다.

웨이퍼 아키텍처별 시장 전망



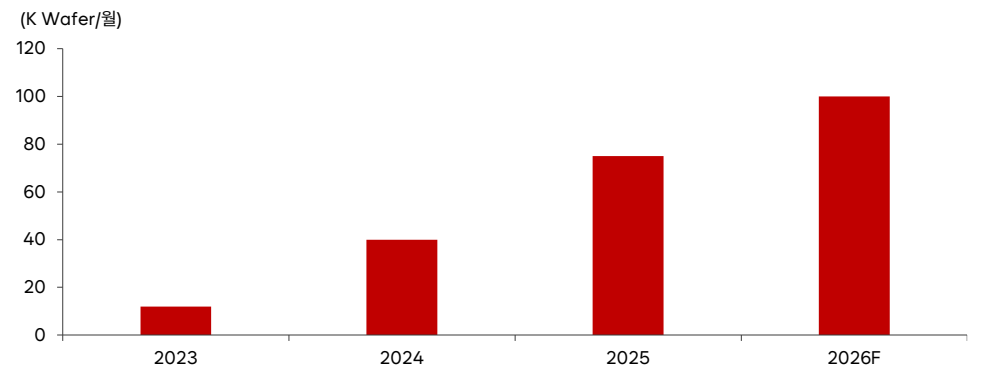
자료: Besi, 한국IR협의회 기업리서치센터

Chiplet 도입으로 자본 집약도 증가



자료: Besi, Intel, IR협의회 기업리서치센터

TSMC CoWoS CAPA 전망



자료: Counterpoint, 한국IR협의회 기업리서치센터



투자포인트

Advanced Package 확대 수혜 전망

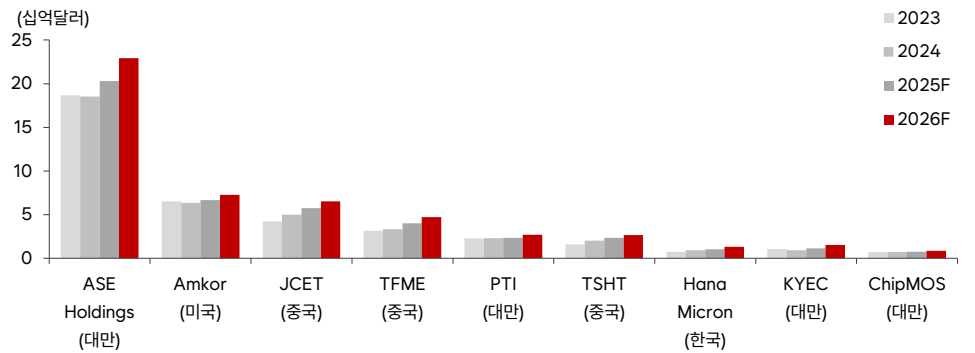
HBM 및 2.5D 패키징 시장 확대에 따른 고객사들의 강한 투자로 인해 동사의 디스펜서를 중심으로 한 후공정 장비 공급 물량 확대가 기대

HBM 및 2.5D 패키징 시장 확대에 따른 동사 장비 수요 증가가 기대된다. Nvidia, AMD, Intel 등의 AI 가속기 출하량이 지속적으로 확대되고 이를 최종 테스트 및 패키징하는 OSAT의 가동률도 높은 수준을 보이고 있다. 또한 CSP의 자체 ASIC 채택이 확대됨에 따라 OSAT 업체의 고객사도 다변화되는 움직임이다. 이에 더해 중국 외 지역에 생산 거점을 둔 업체들이 글로벌 빅테크 기업들의 선호를 받으며 성장하고 있다. 2.5D, 3D 패키징 기술이 AI 칩의 필수 요소가 되고 있으며 2026년은 역사상 처음으로 첨단 패키징 매출이 일반 패키징 매출을 넘어설 것으로 예상된다. AI 수요 확대에 따라 TSMC 뿐만 아니라 ASE, Amkor 등도 AI 전용 라인을 확대 중에 있으며 삼성전자, SK하이닉스 등은 HBM4를 위한 투자를 진행하고 있다. 전반적으로 후공정의 난이도가 지속적으로 높아지며 이를 감당할 수 있는 상위 OSAT로의 물량 쏠림과 단가 상승이 발생 중이다.

동사의 주요 고객사는 한국에 진출해 있는 글로벌 OSAT 및 국내 메모리 업체를 비롯하여 아시아 후공정 팹을 보유한 업체이다. 삼성전자는 천안에 패키징 팹을 증설하는 한편 미국 테일러 팹에 선단 패키징 라인을 추가할 예정이다. SK하이닉스는 청주 P&T7과 미국 Arizona에 선단 패키징 팹을 투자한다. 글로벌 1위 OSAT인 ASE는 2.5D, 3D 패키징 수요에 적극 대응 중이다. TSMC가 소화하지 못하는 AI 가속기용 CoWoS-R 외주 물량을 흡수하기 위해 대만 가오슝 캠퍼스와 자회사 SPIL 탄즈, 열린 팹, 말레이시아 페낭 등을 중심으로 투자를 확대 중이다. 이를 통해 Nvidia, AMD 등 주요 AI 반도체 물량을 소화할 것으로 보인다. Amkor는 한국 인천 송도와 미국 Arizona를 중심으로 선단 패키징 생산 능력을 확대 중이다. TSMC CoWoS-S 외주 물량을 Arizona에서 집중적으로 소화할 것으로 보이고 Google의 TPU 관련 주문도 포함될 것으로 보인다. Intel의 2.5D 패키징 기술인 EMIB도 처음으로 외주 물량이 나올 것으로 보인다. 이는 한국 인천에서 소화할 예정이다. 한국은 주로 2.5D 패키징 및 HBM 수요에 대응한다. Amkor는 이를 비롯하여 AI 반도체와 모바일 반도체 수요 대응을 위해 한국 인천 송도에 2,660억 원을 투자해 3개 신규 라인을 증설할 예정이다.

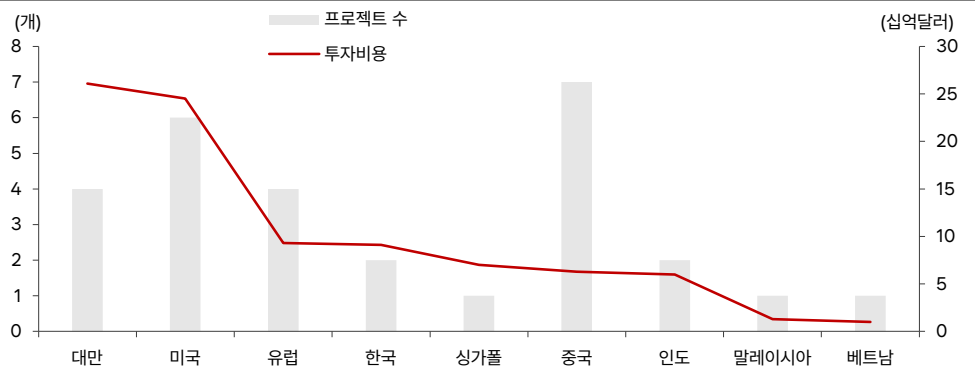
동사는 글로벌 디스펜서 시장 점유율 약 10% 수준이나 아시아 점유율은 이를 상회하며 한국 시장에서의 점유율은 약 80%인 것으로 파악된다. 고객사들의 강한 투자로 인해 동사의 디스펜서를 중심으로 한 후공정 장비 공급 물량 확대가 기대된다. 특히 선단 패키징 중심의 투자 집행으로 동사 장비도 고사양 장비가 주를 이뤄 단가 및 수익성 개선이 동반될 것으로 전망된다. 동사는 Intel을 신규 거래처로 확보하고 글로벌 OSAT향 공급 확대가 구조적 성장 요인으로 작용하여 후공정 장비 수요 회복 구간에서 수혜가 예상된다.

글로벌 OSAT 업체 매출액 추이 및 전망



자료: Refinitiv, 한국IR협회의 기업리서치센터

후공정 팹 국가별 프로젝트



자료: Technights, Besi, 한국IR협회의 기업리서치센터

신규장비로 다변화 기대

신규 장비군 중심으로 기존 디스펜서 중심에서 고부가 본딩 장비사로의 체질 개선 가속화 중

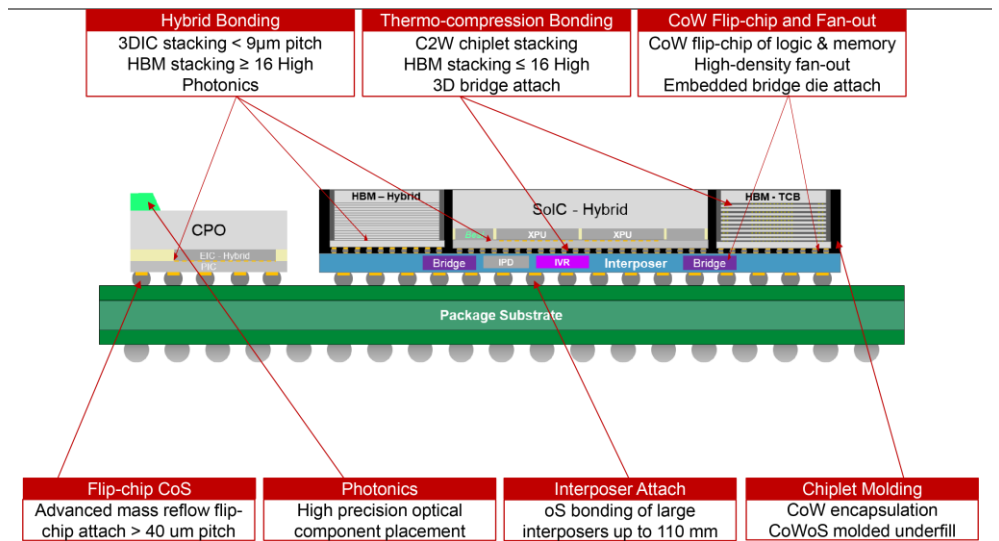
디스펜서 외 장비로의 다변화가 기대된다. 동사는 Attach, Laser Bonder, Micro Solder ball Attach 등의 신규 장비군을 보유하고 있다. 글로벌 Attach 장비 시장 규모는 약 16억 달러이며 어드밴스드 패키징 시장에서는 Besi(네덜란드), EVG(오스트리아), ASMPT(싱가포르) 등 해외 업체가 시장의 대부분을 차지하고 있다. 동사의 장비는 칩의 정밀 정렬(Alignment) 및 가접합(Pre-bonding)을 수행하며, I/O 단자 미세화에 따른 공정 난이도 상승 속에서 외산 대비 경쟁력 있는 수율을 입증하였다. 동사의 Attach 장비는 실장 정밀도와 다양한 픽앤플레이스(Pick and Place) 헤드 옵션을 통해 공정 유연성을 확보하고 있다. 이를 바탕으로 2024년 삼성전자로부터 약 250억 원 규모의 장비 공급 계약을 체결하였고 2025년 공급하였다. 삼성전자로부터 수주한 HBM향 장비 공급으로 연간 약 50~100억원 수준에 머물던 본딩 장비군 매출액은 2025년 약 300억원으로 확대되었다. 칩렛 구조의 확산으로 초정밀 다이 배치의 중요성이 강조되고 있는 시장 환경에서 하이엔드 본딩 시장에서 국산화 레퍼런스를 확보 동사 Attach 장비의 성장이 기대된다.

동사의 레이저 본딩은 Laser Reflow 장비(Laser Assisted Bonder)와 가압 기능이 포함된 Laser Compression Bonder가 있다. Amkor와 공동 개발한 레이저 리플로우(LAB) 장비는 IR 레이저를 활용한 선택적 가열 방식을 채택한다. 국소 부위에 정밀 레이저를 조사하여 기판 휨(Warpage) 문제를 해결할 수 있어 기존 매스 리플로우(Mass Reflow) 공정을 대체 가능하다. Warpage 및 열 스트레스 이슈를 개선하여 얇은 기판 공정에서도 품질 안정성을 유지

하는 장점이 있다. LCB는 기존 TC 본더의 낮은 생산성을 극복하기 위해 정렬 기술과 레이저 리플로우를 결합한 장비로 극초정밀 배치 사양을 구현한다. 메모리향 TC 본더 시장의 과열 경쟁을 피해 현재 대만 탑티어 OSAT 업체를 대상으로 2.5D 패키징용 매출을 발생시키고 있다. Besi가 주도하는 하이브리드 본딩 시대로 가기 전 가장 큰 시장인 2.5D, CoWoS 공정 내 TCB 대체 수요를 흡수할 것으로 기대된다.

마이크로 솔더볼 어태치는 향후 Cu Pillar 전환 확대에 따른 수혜가 기대된다. 기존 솔더볼 방식은 리플로우 공정에서 볼이 녹으면서 옆으로 퍼지는 성질 때문에 인접한 볼끼리 붙는 브릿지(Bridge) 현상이 발행하여 미세 피치를 구현하는데 어려움이 있다. 반면 카퍼 필러는 기둥 형태의 구리 구조물 위에 얇은 솔더 캡을 씌운 구조이다. 구리는 리플로우 시에도 녹지 않고 형태를 유지하여 좁은 간격(Fine Pitch, 30~40µm 수준)에서도 일정한 높이를 유지하며 I/O 밀도를 높일 수 있다. 즉, 데이터 전송 속도 향상 및 피치 미세화를 위해 기존 솔더볼이 카퍼 필러로 대체되는 추세에 있다. 일본 자회사 미니미와 협업하여 개발한 동사의 Micro SBM 장비는 초미세 볼까지 대응 가능하고 솔더볼과 카퍼 필러 어태치가 모두 가능한 하이브리드 솔루션으로 고객의 공정 전환 비용을 절감 가능한 장점이 있다. 2026년 카퍼 필러향 장비 판매를 기대한다. 동사는 신규 장비들을 중심으로 기존 디스펜서 중심에서 고부가가치 본딩 장비사로의 체질 개선이 가속화될 것으로 판단한다.

AI Chiplet 패키지에 요구되는 Advanced Packaging 기술

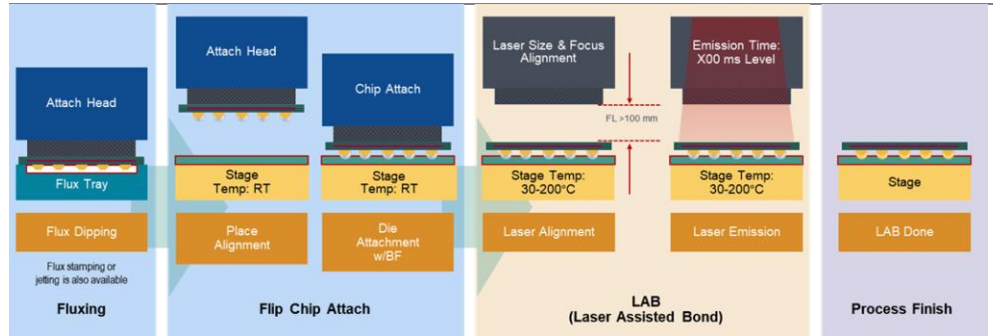


주: 1) Hybrid Bonding: 하이브리드 본딩, Thermo-compression Bonding: 열압착 본딩, CoW Flip-chip and Fan-out: CoW(Chip on Wafer) 플립칩 및 팬아웃, Flip-chip CoS: Chip on Substrate 플립칩, Photonics: 포토닉스 (광학 소자), Interposer Attach: 인터포저 부착, Chiplet Molding: 칩렛 몰딩

2) HBM 메모리, SoIC, XPU 등 여러 칩들이 하이브리드 본딩, 열압착 본딩, 플립칩 방식으로 인터포저 및 브릿지를 통해 패키지 기판에 접합되며, CPO(광학 공동 패키징)와 포토닉스 기술도 통합되어 있음. 이는 3D 이종 집적(Heterogeneous Integration) 기술로 고성능 컴퓨팅과 AI 칩에 사용되는 최신 패키징 솔루션

자료: Besi, IR협의회 기업리서치센터

레이저 본딩



주: Fluxing(플럭스 처리) → Flip Chip Attach(칩 부착) → LAB(레이저 보조 본딩) → Process Finish

Fluxing(플럭스 처리): Attach Head: 칩을 픽업하는 헤드, Flux Tray: 플럭스가 담긴 트레이, Flux Dipping: 칩을 플럭스에 담가 코팅,

lip Chip Attach(플립칩 부착): Attach Head: 플럭스 처리된 칩을 픽업, Chip Attach: 칩을 뒤집어서(Flip) 기판에 배치, Place Alignment: 칩의 정확한 위치 정렬,

Die Attachment w/BF: 다이를 부착하며, BF(Bottom Fill/Underfill)로 칩 하부 공간 충진

LAB (Laser Assisted Bond, 레이저 보조 본딩): Laser Size & Focus Alignment: 레이저 빔 크기와 초점 조정, Laser Emission (레이저 조사)

자료: Semiconductor Engineering, IR협의회 기업리서치센터

슬러블, 카퍼 필러 비교

	SnPb C4 Bump	Pb-Free C4 Bump	Cu Pillar + Pb-free Cap	Cu μ -Pillar + Pb-free Cap
Structure				
Diameter	75 – 200 μ m	75 – 150 μ m	50 – 100 μ m	10 – 30 μ m
	Old Technology	Current Technology		Next-Generation Technology

자료: Qnity, IR협의회 기업리서치센터

실적 추이 및 전망

1 Advanced Package 수요 강세로 호실적 기록한 2025년

2025년 매출액, 영업이익은 각각 2,302억 원(+35.2% YoY), 463억 원(+244.0% YoY) 기록

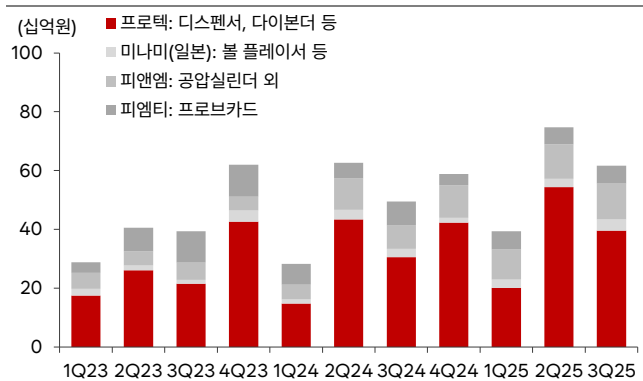
2025년 동사의 실적은 매출액 2,302억 원(+35.2% YoY), 영업이익 463억 원(+244.0% YoY)을 기록하였다(잠정 실적). AI 반도체 강세로 인해 Advanced Package 수요가 증가하며 고사양 장비 중심의 성장을 보였다. 고사양 디스펜서 판매 확대로 디스펜서 매출액은 전년 대비 약 10% 증가한 것으로 파악된다. Attach 장비는 2024년 삼성전자로부 터 수주분이 연간으로 반영되어 약 300억 원의 매출액을 기록할 것으로 보인다. 레이저 장비는 한국 및 대만 OSAT 공급으로 매출액 250억 원으로 확대되었다. 수익성 측면에서는 2024년에 일시적으로 증가하였던 원자재 가격, 신제품 연구 개발비 등의 요소가 제거되었고 매출액 증가 효과로 인해 전년 대비 12.2%p 개선된 OPM 20.1%를 기록하였다.

2 레이저 장비군 성장 기대되는 2026년

2026년 매출액 2,571억 원(+11.7% YoY), 영업이익 576억 원(+24.6% YoY) 전망

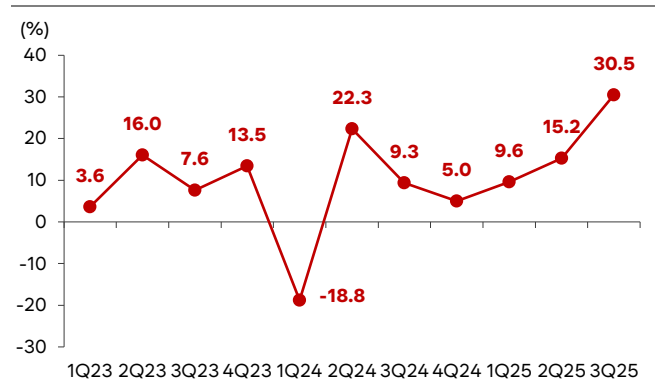
2026년 실적은 매출액 2,571억 원(+11.7% YoY), 영업이익 576억 원(+24.6% YoY)을 전망한다. 2025년에 이어 Advanced Package향 고사양 장비 수요 강세가 기대된다. 국내 메모리 업체의 HBM 투자와 ASE, Amkor 등 OSAT 업체의 2.5D Packaging 투자가 이어지고 있다. 이에 따라 고사양 디스펜서의 수요가 꾸준히 확대될 것으로 기대된다. Attach 장비는 OSAT향 수요는 지속되는 가운데 고객사의 HBM 투자 속도와 물량에 따라 실적 업사이드가 발생할 것으로 예상된다. 레이저 장비군은 전년 대비 약 20%의 성장이 기대된다. 특히 LCB 장비는 극초정밀 배치 사양 구현이 가능하고 Warpage 및 열스트레스 이슈가 개선 가능한 장점을 바탕으로 2.5D Packaging 공정에서 적용이 확대되고 있다. 한국 및 타이어 대만 OSAT향 수요가 2026년 강하게 발생할 것으로 기대된다. 특히 레이저 장비군은 기존 디스펜서 대비 고가의 장비로 레이저 장비군 매출액 확대가 전사 수익성 개선에도 긍정적 영향을 끼칠 것으로 판단된다. 마이크로 솔더볼 어태치는 Cu Pillar향 공급이 개시될 것으로 기대된다. 수익성 측면에서는 매출액 확대 및 고사양 디스펜서 공급 확대, 수익성 높은 레이저 장비군 판매 증가로 전년대비 2.3%p 개선된 OPM 22.4%를 전망한다.

프로텍 부문/분기별 매출액 추이



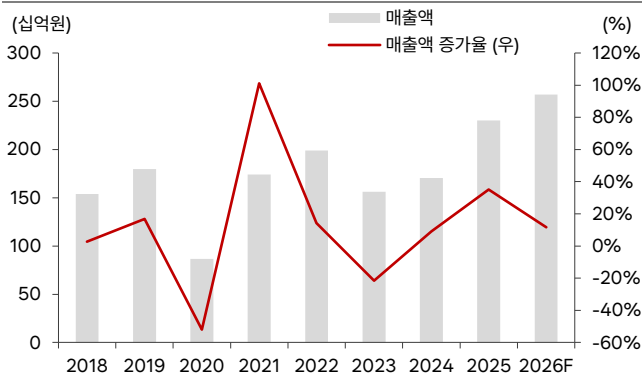
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

프로텍 분기별 영업이익률 추이



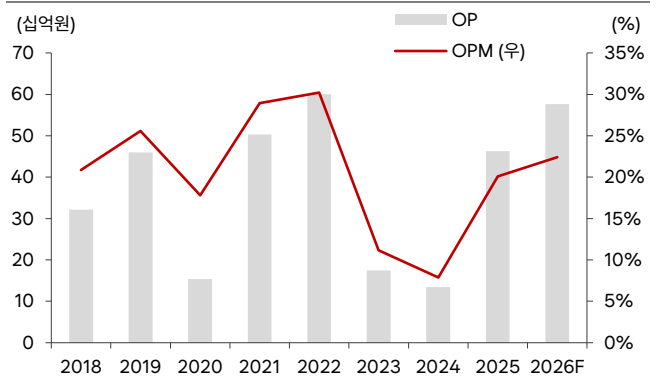
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

프로텍 매출액 및 매출액 증가율 추이



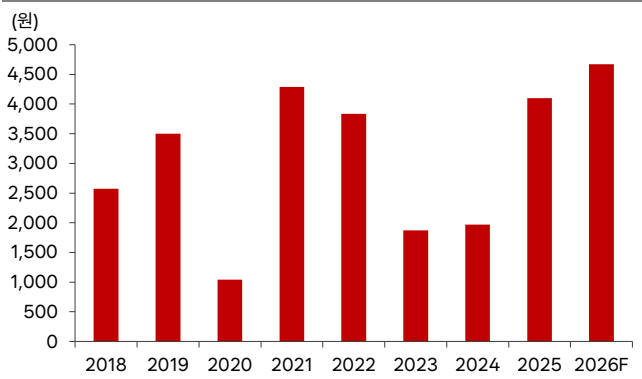
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

프로텍 영업이익 및 영업이익률 추이



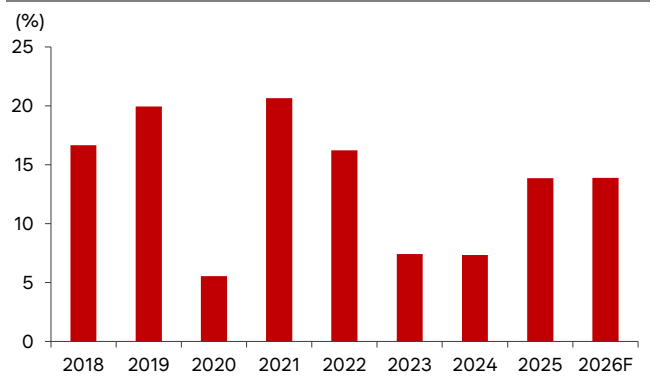
자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

프로텍 EPS 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

프로텍 ROE 추이



자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

프로텍 부문별 실적

(단위: 십억원)

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	2023	2024	2025F	2026F
매출액	24.8	37.8	35.8	57.8	25.3	52.6	43.1	49.3	30.4	64.5	51.0	156.1	170.3	230.2	257.1
프로텍	17.5	26.0	21.5	42.7	14.8	43.4	30.6	42.3	20.1	54.4	39.5	107.7	131.0	185.0	209.4
미나미	2.3	1.7	1.3	3.8	1.4	3.3	2.8	1.6	2.8	2.9	3.9	9.1	9.1	13.5	14.3
피앤엠	5.4	4.8	5.9	4.7	5.0	10.7	7.9	11.2	10.3	11.7	12.2	20.7	34.7	51.2	56.1
피엠티	3.5	8.1	10.6	10.8	7.1	5.3	8.2	3.8	6.2	5.8	6.0	33.0	24.4	24.8	26.0
기타 및 내부거래제거	-4.0	-2.8	-3.6	-4.2	-3.0	-10.0	-6.4	-9.5	-9.0	-10.3	-10.6	-14.5	-28.9	-44.4	-48.8
영업이익	0.9	6.0	2.7	7.8	-4.8	11.7	4.0	2.4	2.9	9.8	15.6	17.4	13.4	46.3	57.6
지배주주순이익	2.9	6.7	3.5	7.6	-0.7	12.5	2.0	7.8	4.7	9.0	13.7	20.6	21.7	45.1	51.4
Margin(%)															
영업이익률	3.6	16.0	7.6	13.5	-18.8	22.3	9.3	5.0	9.6	15.2	30.5	11.2	7.9	20.1	22.4
지배주주순이익률	11.5	17.6	9.9	13.1	-2.6	23.8	4.6	15.9	15.6	14.0	26.9	13.2	12.7	19.6	20.0
YoYGrowth(%)															
매출액	-41.2	-34.3	-13.9	0.3	2.1	39.3	20.5	-14.7	20.2	22.6	18.4	-21.5	9.1	35.2	11.7
프로텍	-	-	-	-	-15.5	66.7	42.0	-0.9	36.0	25.3	29.3	-39.6	21.6	41.2	13.2
미나미	-	-	-	-	-39.2	90.0	116.4	-58.3	97.9	-11.9	36.0	-24.5	-0.5	49.2	5.7
피앤엠	-	-	-	-	-7.1	124.2	33.8	139.4	104.7	10.2	54.8	-19.4	67.6	47.7	9.5
피엠티	-	-	-	-	100.5	-34.1	-22.8	-64.9	-12.3	9.2	-26.3	-13.6	-26.2	1.5	5.1
기타 및 내부거래제거	-	-	-	-	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지
영업이익	-92.7	-66.8	-78.0	-54.8	적전	93.9	48.7	-68.5	흑전	-16.2	286.4	-71.0	-22.9	244.0	24.6
지배주주순이익	-73.4	-58.7	-73.9	328.3	적전	88.0	-44.2	3.8	흑전	-28.1	593.4	-51.1	5.2	107.8	14.0
QoQGrowth(%)															
매출액	-57.0	52.4	-5.2	61.4	-56.2	107.8	-18.0	14.3	-38.3	112.0	-20.8				
프로텍		48.6	-17.3	98.2	-65.3	193.3	-29.6	38.4	-52.4	170.3	-27.3				
미나미		-25.4	-23.2	189.8	-63.3	133.1	-12.6	-44.1	73.9	3.8	34.9				
피앤엠		-12.1	23.9	-20.8	7.7	112.2	-26.1	41.7	-7.9	14.2	3.9				
피엠티		128.4	31.5	2.0	-34.5	-25.0	54.1	-53.7	63.8	-6.6	4.1				
기타 및 내부거래제거		적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지				
영업이익	-94.8	570.5	-55.2	187.4	적전	흑전	-65.7	-39.2	19.3	236.8	58.2				
지배주주순이익	62.1	132.7	-46.8	113.4	적전	흑전	-84.2	296.4	-39.5	89.7	52.4				

자료: FnGuide QuantiWise, 한국IR협의회 기업리서치센터

Valuation

1 2026F PER 10.9x

현주가는 Historical PER Band 중하단에 위치. 기존 디스펜서 중심에서 본딩 장비군으로 장비 다변화 이루어지고 있고, 높은 EPS 성장을 고려시 상대적으로 저평가 구간에 있다고 판단

동사의 현주가는 2026F PER 10.9x로 Historical PER Band(4.8x~37.0x) 중하단에 위치해 있다. 동사의 Peer 업체로는 국내 반도체 후공정 장비 업체들과 네덜란드 Besi, 미국 Nordson 등을 선정하였다. Peer 업체의 2026F 평균 PER은 36.7x 수준이다. Besi는 글로벌 탭티어 후공정 업체로 하이브리드 본딩 장비 시장을 선도하며 높은 이익 성장을 보이고 있다. 이에 따라 Besi의 PER도 48.2x로 높은 평가를 받고 있다. 국내 Peer 중 한미반도체와 이오테크닉스는 50.7x, 43.5x의 높은 Valuation을 부여받고 있다. 한미반도체는 TC본더의 강자로 HBM 수혜를 받으며 성장하고 있고 이오테크닉스는 레이저 장비 중심으로 다변화된 장비군을 보유하고 있다. 두 업체 모두 시장 지배력, 높은 수익성 등이 높은 밸류에이션의 이유라 판단된다.

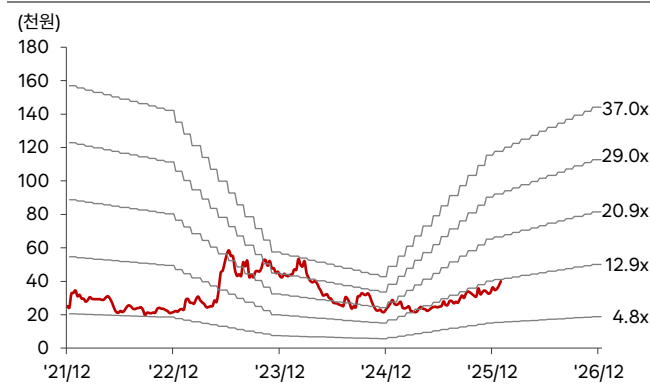
Peer 중 동사와 유사한 Valuation 수준을 보이는 기업은 Nordson과 피에스케이홀딩스이다. Nordson은 글로벌 디스펜서 시장 1위 기업이며 피에스케이홀딩스는 리플로우 장비를 생산하는 점에서 동사와 경쟁 관계에 있다. Nordson의 2026년 EPS 성장률은 19%, 피에스케이홀딩스는 18%로 프로텍의 25% 대비 낮으나 PER은 24.4x, 16.9x로 프로텍 대비 높게 형성되어 있다. 동사는 기존 디스펜서 중심에서 점진적으로 본딩 장비군으로 장비 다변화가 이루어 지고 있고, 두 업체 대비 높은 EPS 성장률을 반영한다면 현주가는 상대적으로 저평가 구간에 있다고 판단된다.

동종 업종 밸류에이션

프로텍	종가 (원, 달러)	시가총액 (십억원, 백만달러)	매출액(십억원, 백만달러)			PER(배)			PBR(배)		
			2024	2025F	2026F	2024	2025F	2026F	2024	2025F	2026F
코스피	5,221	4,187,040	3,752,926	3,044,337	3,355,340	-	17.9	11.0	-	1.7	1.5
코스닥	1,164	637,524	334,116	111,150	128,586	-	51.8	29.2	-	3.8	3.4
프로텍	40,000	440	170	230	257	11.1	9.8	10.9	0.8	1.3	1.4
한미반도체	203,500	19,396	559	631	816	52.5	73.7	50.7	14.5	26.6	18.7
이오테크닉스	360,500	4,441	321	383	481	40.0	76.3	43.5	2.8	6.9	6.1
피에스케이홀딩스	78,600	1,695	216	205	233	8.6	19.2	16.9	1.9	3.3	2.8
Besi(네덜란드)	163	15,765	638	702	1,010	59.5	96.5	48.2	20.9	28.7	24.6
Nordson(미국)	272	15,318	2,707	2,811	2,932	30.6	27.3	24.4	4.8	4.3	4.6
동종업종 평균						38.2	58.6	36.7	9.0	14.0	11.4

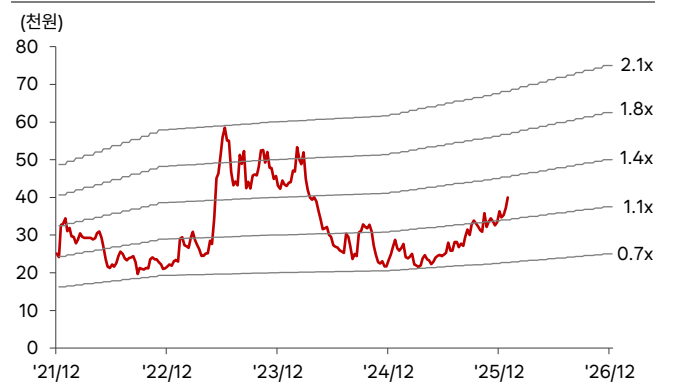
주: 2026년 01월 29일 종가 기준. 동종그룹 25F, 26F는 시장 컨센서스 사용
 자료: FnGuide QuantilWise, Refinitiv, 한국IR협의회 기업리서치센터

프로텍 PER Band



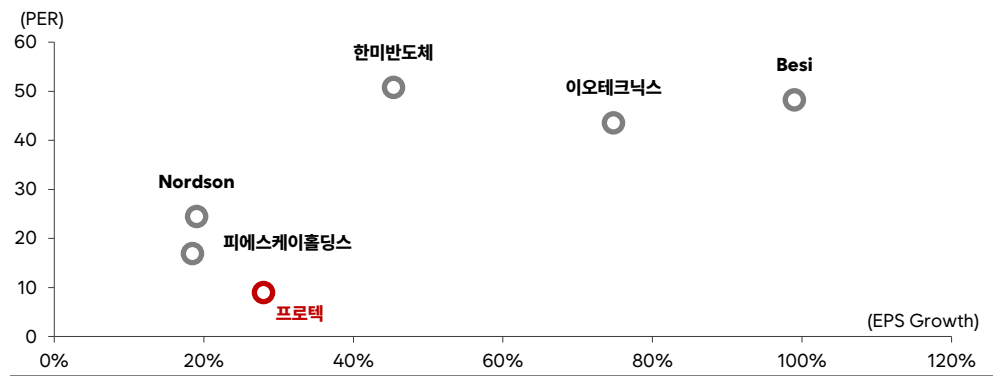
자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

프로텍 PBR Band



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

Peer 업체 PER 및 EPS 성장률



자료: FnGuide, 한국IR협회의 기업리서치센터

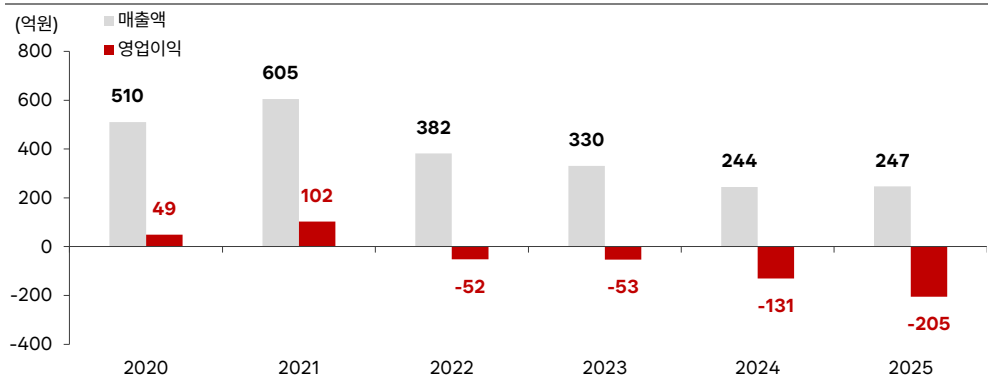
⚠ 리스크 요인

❏ 자회사 피엠티의 부진

자회사 피엠티의 영업 적자 확대는 전사 이익 개선에 부담. 향후 NAND 업황 개선에 따른 프로브 카드 공급 물량 증가는 동사 이익 개선 속도를 가속화할 것으로 기대

반도체 업황의 변동성을 제외한다면 동사의 리스크 요인은 자회사 피엠티의 실적 부진이라 판단된다. 피엠티는 프로브 카드 제조 업체로 MEMS 기술을 활용한 NAND 프로브 카드를 주력으로 생산한다. 피엠티는 2022년부터 매출액이 크게 감소하며 적자를 기록 중이다. 2025년에는 매출액 247억원, 영업적자 205억으로 적자폭이 확대되었다. 이는 제품 단위당 제조 원가가 상승하고 재고 평가 손실이 발생했기 때문이다. 2025년 중반까지 이어졌던 NAND 시장 업황 부진과 NAND 프로브 카드 시장에서 경쟁 심화가 매출액 하락 요인으로 판단된다. 지속적으로 확대되는 피엠티의 영업손실은 동사 이익 개선에 부담이다. 실제로 동사는 과거 대비 높은 매출액 규모를 기록함에도 피엠티 영향으로 이익률은 더 낮은 상황이다. NAND 업황도 호황으로 진입한 만큼 프로브 카드 공급 물량을 확대시켜 적자폭이 축소된다면 프로텍의 이익 개선 속도도 빨라질 것으로 판단된다.

피엠티 매출액 및 영업이익 추이



주: 2025년은 잠정 실적, 자료: FnGuide, 한국IR협의회 기업리서치센터

포괄손익계산서

(억원)	2022	2023	2024	2025F	2026F
매출액	1,988	1,561	1,703	2,302	2,571
증가율(%)	14.2	-21.5	9.1	35.2	11.7
매출원가	1,204	1,113	1,310	1,519	1,671
매출원가율(%)	60.6	71.3	76.9	66.0	65.0
매출총이익	784	447	393	783	900
매출이익률(%)	39.4	28.7	23.1	34.0	35.0
판매관리비	183	273	258	320	323
판매비율(%)	9.2	17.5	15.1	13.9	12.6
EBITDA	625	250	221	560	670
EBITDA 이익률(%)	31.4	16.0	13.0	24.3	26.1
증가율(%)	18.6	-59.9	-11.8	153.5	19.7
영업이익	601	174	134	463	576
영업이익률(%)	30.2	11.2	7.9	20.1	22.4
증가율(%)	19.3	-71.0	-22.9	244.0	24.6
영업외손익	-21	46	66	30	31
금융수익	18	31	39	40	44
금융비용	4	12	24	23	27
기타영업외손익	-35	27	51	13	13
중속/관계기업관련손익	-20	0	-0	30	-0
세전계속사업이익	560	220	200	523	607
증가율(%)	-3.8	-60.7	-9.1	161.2	16.0
법인세비용	137	49	73	171	157
계속사업이익	423	171	127	352	450
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	423	171	127	352	450
당기순이익률(%)	21.3	11.0	7.5	15.3	17.5
증가율(%)	-10.2	-59.6	-25.4	176.1	28.0
지배주주지분 순이익	422	206	217	451	514

현금흐름표

(억원)	2022	2023	2024	2025F	2026F
영업활동으로인한현금흐름	468	259	191	238	442
당기순이익	423	171	127	352	450
유형자산 상각비	22	68	78	90	87
무형자산 상각비	2	8	8	8	7
외환손익	51	8	2	0	0
운전자본의감소(증가)	-100	21	-89	-222	-112
기타	70	-17	65	10	10
투자활동으로인한현금흐름	-40	-115	-729	-431	-61
투자자산의 감소(증가)	2,550	3,455	5,853	-1	-1
유형자산의 감소	3	0	1	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-41	-79	-56	-420	-50
기타	-2,552	-3,491	-6,527	-10	-10
재무활동으로인한현금흐름	-246	74	2	175	-36
차입금의 증가(감소)	-1	116	41	211	0
사채의증가(감소)	0	0	0	0	0
자본의 증가	0	0	0	0	0
배당금	-39	-37	-36	-36	-36
기타	-206	-5	-3	0	0
기타현금흐름	-25	-6	2	1,048	0
현금의증가(감소)	157	213	-535	1,030	346
기초현금	449	606	819	284	1,313
기말현금	606	819	284	1,313	1,659

재무상태표

(억원)	2022	2023	2024	2025F	2026F
유동자산	2,144	2,281	2,452	2,745	3,247
현금성자산	606	819	284	1,313	1,659
단기투자자산	480	510	1,141	93	93
매출채권	534	350	376	490	548
재고자산	502	570	619	804	897
기타유동자산	23	32	33	44	49
비유동자산	1,318	1,342	1,316	1,640	1,597
유형자산	1,174	1,198	1,157	1,487	1,450
무형자산	77	72	67	59	52
투자자산	38	33	58	59	60
기타비유동자산	29	39	34	35	35
자산총계	3,462	3,623	3,768	4,385	4,844
유동부채	404	411	459	539	578
단기차입금	91	160	134	134	134
매입채무	66	64	81	99	110
기타유동부채	247	187	244	306	334
비유동부채	26	69	80	301	306
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	45	47	257	257
기타비유동부채	26	24	33	44	49
부채총계	430	479	540	840	884
지배주주지분	2,696	2,856	3,042	3,457	3,934
자본금	55	55	55	55	55
자본잉여금	160	162	170	170	170
자본조정 등	-328	-328	-328	-328	-328
기타포괄이익누계액	-19	-20	-16	-16	-16
이익잉여금	2,828	2,987	3,162	3,577	4,054
자본총계	3,032	3,144	3,228	3,544	3,959

주요투자지표

	2022	2023	2024	2025F	2026F
P/E(배)	5.5	24.4	11.1	9.8	10.9
P/B(배)	0.9	1.8	0.8	1.3	1.4
P/S(배)	1.2	3.2	1.4	1.9	2.2
EV/EBITDA(배)	2.7	16.7	6.4	5.2	6.5
배당수익률(%)	2.4	0.9	1.8	1.0	0.8
EPS(원)	3,834	1,874	1,971	4,096	4,668
BPS(원)	24,506	25,963	27,656	31,425	35,766
SPS(원)	18,070	14,188	15,481	20,927	23,369
DPS(원)	500	400	400	400	400
수익성(%)					
ROE	16.2	7.4	7.4	13.9	13.9
ROA	13.4	4.8	3.4	8.6	9.8
ROIC	25.8	6.4	4.3	13.6	16.4
안정성(%)					
유동비율	531.2	555.5	534.0	509.5	561.3
부채비율	14.2	15.2	16.7	23.7	22.3
순차입금비율	-32.6	-35.6	-36.3	-26.6	-32.5
이자보상배율	711.4	34.3	16.1	35.7	34.3
활동성(%)					
총자산회전율	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6
매출채권회전율	4.2	3.5	4.7	5.3	5.0
재고자산회전율	4.2	2.9	2.9	3.2	3.0

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 '투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목'의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.
 ※관련근거 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의 7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
프로텍	X	X	X

발간 History

발간일	제목
2026.02.04	프로텍-선단 패키징 수요와 함께 성장
2023.03.23	프로텍-반도체 디스펜서에 특화된 후공정 설비업체

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성은 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증명자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 지적재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(<https://t.me/kirsofficial>)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '소·중·한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '소·중·한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.